

第28回若手研究会セミナー

【基礎から分かる半導体前工程】

～ロジックデバイスプロセスの基本と技術的な変遷および
今後期待される新規デバイス～

2023年3月3日（金）13:30～17:00

開催方式：現地参加&オンライン視聴

現地：I-siteなんば 2階 定員 70名

https://www.omu.ac.jp/isite/dir1/dir2/index_5.html

オンライン参加(ZOOMウェビナー)：100名

講師：福田 昭氏

技術ジャーナリスト/ライター/アナリスト

講演概要（予告なく変更されることがあります）

半導体製造工程は大別すると前工程（ウエハー処理工程）と後工程（パッケージング工程）に分かれる。本セミナーではCMOSロジックの前工程を基礎の基礎から説明するとともに、前工程とトランジスタの技術的な変遷を過去から現在まで振り返る。また将来の実用化が期待される次世代の前工程技術と次世代のトランジスタ技術を展望する。

プログラム

（質疑応答と休憩の時間は予告なく変更されることがあります）

13：30～14：30 CMOSロジック前工程の基礎

前工程とトランジスタの技術的な変遷を過去から現在まで

14：30～15：00 質疑応答

15：00～15：25 休憩

15：25～16：25 将来の実用化が期待される次世代の前工程技術と次世代のトランジスタ技術

16：25～16：55 質疑応答

* 定員170名(先着申込順)

* 参加費「クーポン利用可：1名／枚」

会員／賛助会員／協賛学会会員：3,000円 シニア会員：2,000円

非会員：5,000円、学生会員：無料、一般学生：2,000円

* 申し込みは、下記参加申し込みサイトからお願いします。

参加申し込みサイト

申し込み締め切り：2023年2月28日（火）

・この機にエレクトロニクス実装学会への入会を希望される方は、下記URLから登録をお願いします。

<https://service.kktcs.co.jp/smms2/entry/jiep>

申し込み後に会員番号、PWが送付されますので、会員登録後申込みください。

問合先：

エレクトロニクス実装学会関西支部事務局info@jiep.or.jpにご送付ください。